

天水华天科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）2011年非公开发行股票募集资金

1、募集资金的数额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]889号《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年10月以非公开的方式发行人民币普通股（A股）32,900,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为365,848,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币350,518,000.00元。该次募集资金于2011年10月21日全部到达募集资金专项账户，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并出具国浩验字[2011]703A173号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并设立募集资金专项账户对募集资金实行专户存放。

2011年11月4日，公司与交通银行股份有限公司天水支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《非公开发行股票预案》，公司募集资金投资项目“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目通过全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“华天西安”）实施，公司通过募集资金专户向华天西安增资133,000,000.00元用于该募集资金投资项目建设。华天西安于2011年11月8日与昆仑银行股份有限公司西安分行和国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2014 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金专户存放情况如下：

单位：（人民币）元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	截止日余额	备注
天水华天科技股份有限公司	交通银行股份有限公司天水支行	729030110018010012838	217,518,000.00	179,287.83	217,697,287.83	0.00	已销户
华天科技（西安）有限公司	昆仑银行股份有限公司西安分行营业部	79102000048580000038	133,000,000.00	1,318,351.92	134,318,351.92	0.00	已销户
合计			350,518,000.00	1,497,639.75	352,015,639.75	0.00	

（二）2013 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金的数额、资金到账时间情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009 号《关于核准天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2013 年 8 月 12 日向社会公开发行 461 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次公开发行可转债募集资金总额为 461,000,000.00 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 451,333,500.00 元。该次募集资金于 2013 年 8 月 16 日全部到达募集资金专项账户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2013]第 209A0002 号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户的存放情况

公司设立募集资金专项账户对募集资金实行专户存放，2013 年 8 月 28 日，公司与中国光大银行兰州分行营业部、第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目“40 纳米集成电路先进封装测试产业化”项目通过全资子公司华天西安实施，公司通过募集资金专户向华天西安增资 150,000,000.00 元用于该募集资金投资项目建设。华天西安于 2013 年 9 月 4 日与中国光大银行西安雁塔路支行和第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2014年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

单位：（人民币）元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	截止日余额	备注
天水华天科技股份有限公司	中国光大银行兰州分行营业部	51820188000035423	301,333,500.00	5,341,092.08	279,058,844.48	27,615,747.60	活期
华天科技（西安）有限公司	中国光大银行西安雁塔路支行	78720188000113556	150,000,000.00	238,271.57	150,238,271.57	0.00	已销户
合计			451,333,500.00	5,579,363.65	429,297,116.05	27,615,747.60	

二、前次募集资金使用情况说明

（一）2011 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，该次募集资金已全部使用完毕，累计使用募集资金 352,015,639.75 元（含存款利息），募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目变更情况

募集资金投资项目未发生变更。

3、募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用情况

募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。

4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

5、尚未使用的募集资金使用计划和安排

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

6、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

募集资金项目承诺投资金额 350,518,000.00 元，实际投资金额 352,015,639.75 元，实际投资金额与承诺投资金额差额为 1,497,639.75 元，差额全部为募集资金存款利息。

7、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 239,561,984.66 元募集资金置换预先投入“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化”项目、“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目的自筹资金。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构国信证券股份有限公司就本次募集资金置换情况分别出具了专项报告。

（二）2013 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用该次募集资金 429,297,116.05 元（含存款利息），募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2、募集资金投资项目变更情况

募集资金投资项目未发生变更。

3、募集资金投资项目对外转让、置换及其他使用情况

募集资金投资项目不存在对外转让、置换及其他使用的情况。

4、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

5、尚未使用的募集资金使用计划和安排

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为 27,615,747.60 元，其中募集资金 22,274,655.52 元，募集资金存款利息 5,341,092.08 元。上述余额已全部用于“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目购置设备所开具的尚未到期兑付的不可撤销的即期、远期国际信用证。

6、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

募集资金项目承诺投资金额 451,333,500.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日实际投资金额 429,297,116.05 元（含已投入的募集资金利息 238,271.57 元），各项目差异情况如下：

单位：（人民币）元

承诺投资项目	募集资金承诺投资金额 (1)	截至 2014 年 12 月 31 日实际投资金额		差额 (2) + (3) - (1)
		募集资金 (2)	募集资金利息 (3)	
通讯与多媒体集成电路封装测试产业化	162,018,800.00	139,744,175.69	0.00	-22,274,624.31
40 纳米集成电路先进封装测试产业化	150,000,000.00	150,000,000.00	238,271.57	238,271.57
受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权	139,314,700.00	139,314,668.79	0.00	-31.21

7、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 113,639,494.43 元募集资金分别置换预先投入“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目、“40 纳米集成电路先进封装测试产业化”项目和“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权”项目的自筹资金。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司就本次募集资金置换情况分别出具了专项报告。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）2011 年非公开发行股票募集资金投资项目

1、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3，募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、募集资金投资项目实现效益的情况说明

募集资金用于“铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化”项目、“集成电路高端封装测试生产线技术改造”项目和“集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造”项目，各项目实现效益情况分别说明如下：

（1）铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化项目

该项目已实施完成，于 2012 年 12 月达到可使用状态。该项目近三年（2012 年-2014 年）累计实现效益 9,326.43 万元。达到可使用状态后，累计实现效益 6,659.49 万元，为累计承诺效益的 102.45%。

（2）集成电路高端封装测试生产线技术改造项目

该项目已实施完成，于 2013 年 12 月达到可使用状态。该项目近三年（2012 年-2014 年）累计实现效益 8,976.98 万元。达到可使用状态后，实现效益 4,211.13 万元，为承诺效益的 81.09%。该项目未达到预计效益的原因为项目实施的部分产品价格下降幅度高于预期。

（3）集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造项目

该项目已实施完成，于 2013 年 10 月达到可使用状态。该项目近三年（2012 年-2014 年）累计实现效益 10,555.63 万元。达到可使用状态后，累计实现效益 6,429.41 万元，

为累计承诺效益的 100.88%。

（二）2013 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目

1、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4，募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、募集资金投资项目实现效益的情况说明

募集资金用于“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”项目、“40 纳米集成电路先进封装测试产业化”项目和“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权”项目，各项目实现效益情况分别说明如下：

（1）通讯与多媒体集成电路封装测试产业化项目

该项目还在建设之中，预计于 2015 年底达到可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日，项目完工程度为 59.41%。由于该项目采用边建设边生产的方式实施，设备分批采购和安装调试并投入生产，该项目自 2014 年度形成部分产能，并实现了效益 619.10 万元。

（2）40 纳米集成电路先进封装测试产业化项目

该项目还在建设之中，预计于 2015 年底达到可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日，项目完工程度为 84.11%。由于该项目采用边建设边生产的方式实施，设备分批采购和安装调试并投入生产，该项目自 2013 年度形成部分产能，累计实现效益 1,165.56 万元，其中 2014 年度实现效益 1,059.70 万元。

（3）受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权项目

该项目共计支付受让股权款 139,314,668.79 元，股权受让变更登记工作已完成。公司未在《公开发行可转换公司债券募集说明书》等披露文件中对“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权”项目做任何形式的效益承诺。

（三）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情形。

（四）募集资金投资项目是否存在累计实现收益低于承诺的累计收益 20%以上的情形

公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以

上的情形。

四、前次发行中以资产认购股份的资产的情况

公司前次发行中不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金的实际使用情况与公司已披露的信息文件中的内容一致。

六、董事会意见

公司董事会认为：公司严格按照深圳证券交易所相关规定和本公司《募集资金使用管理办法》管理募集资金专项账户；按照非公开发行预案以及可转债募集说明书披露的募集资金运用方案使用募集资金，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金等事项均按规定履行相关审批程序。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件 1：2011 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 2：2013 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附件 3：2011 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4：2013 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一五年二月二日

附件 1:

2011 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: (人民币) 元

募集资金总额:			350,518,000.00			已累计使用募集资金总额:			352,015,639.75	
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例(%):			0.00			2011 年:			278,378,535.38	
						2012 年:			73,636,961.43	
						2013 年:			142.94	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	201,600,000.00	112,144,073.02	112,144,073.02	201,600,000.00	112,144,073.02	112,144,073.02	0.00	2012 年 12 月 31 日
2	集成电路高端封装测试生产线技术改造	集成电路高端封装测试生产线技术改造	298,400,000.00	133,000,000.00	134,318,351.92	298,400,000.00	133,000,000.00	134,318,351.92	1,318,351.92	2013 年 12 月 31 日
3	集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造	集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造	299,000,000.00	105,373,926.98	105,553,214.81	299,000,000.00	105,373,926.98	105,553,214.81	179,287.83	2013 年 10 月 31 日

附件 2:

2013 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: (人民币) 元

募集资金总额:			451,333,500.00			已累计使用募集资金总额:			429,297,116.05	
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例 (%) :			0.00			2013 年:			263,636,228.26	
						2014 年:			165,660,887.79	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	通讯与多媒体集成电路封装测试产业化	通讯与多媒体集成电路封装测试产业化	160,000,000.00	162,018,800.00	139,744,175.69	160,000,000.00	162,018,800.00	139,744,175.69	-22,274,624.31	59.41%
2	40 纳米集成电路先进封装测试产业化	40 纳米集成电路先进封装测试产业化	150,000,000.00	150,000,000.00	150,238,271.57	150,000,000.00	150,000,000.00	150,238,271.57	238,271.57	84.11%
3	受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85% 股权	受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85% 股权	139,314,700.00	139,314,700.00	139,314,668.79	139,314,700.00	139,314,700.00	139,314,668.79	-31.21	2013 年 12 月 31 日

附件 3:

2011 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：（人民币）万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率（注 1）	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年度	2014 年度		
1	铜线键合集成电路封装工艺升级及产业化	98.58%	3,250.00	2,666.94	3,079.54	3,579.95	9,326.43	是
2	集成电路高端封装测试生产线技术改造	85.57%	5,193.00	891.47	3,874.38	4,211.13	8,976.98	否
3	集成电路封装测试生产线工艺升级技术改造	97.06%	5,463.00	1,149.79	3,502.64	5,903.20	10,555.63	是

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

附件 4:

2013 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：（人民币）万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2012 年度	2013 年度	2014 年度		
1	通讯与多媒体集成电路封装测试产业化	32.50%（注 1）	2,739.00			619.10	619.10	项目尚在建设中
2	40 纳米集成电路先进封装测试产业化	44.42%（注 1）	2,456.00		105.86	1,059.70	1,165.56	项目尚在建设中
3	受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权（注 2）	不适用	不适用		117.83	567.96	685.79	不适用

注 1：公司的“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化”和“40 纳米集成电路先进封装测试产业化”项目尚处于建设中，产能利用率按项目截至 2014 年 12 月 31 日的实际产量与已实施产能之比进行测算。

注 2：公司未在《公开发行可转换公司债券募集说明书》等披露文件中对“受让深圳市汉迪创业投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85% 股权”项目做任何形式的效益承诺。受让股权时参考的评估值系资产基础法评估结果，且该评估结果仅作为参考，并非定价依据。最近三年实际效益，按公司合并口径计算确定的昆山西钛微电子科技有限公司（现已更名为华天科技（昆山）电子有限公司）2013 年 9-12 月的净利润（经审计）408.42 万元、2014 年度的净利润（未经审计）1,968.68 万元所对应的股权比例（28.85%）计算。